

EINLADUNG ZUM TECDAY

IM EVENTHOTEL
PYRAMIDE & CONGRESS CENTER
AM 11. APRIL 2024
2334 VÖSENDORF - WIEN



LIEBE KUNDEN UND TECHNIK-INTERESSIERTE

lassen Sie sich von praxisnahen Vorträgen aus den verschiedenen Bereichen der Leiterplatte inspirieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit mit unseren Experten im Eventhotel Pyramide & Congress Center in Vösendorf ins Gespräch zu kommen, Problemlösungen zu diskutieren und anstehende Projekte zu besprechen, denn wir unterstützen Sie bereits in der frühen Entwicklungsphase Ihrer Produkte.



Termin
Donnerstag, 11 April 2024



Uhrzeit
Beginn ab 08:15 Uhr
Agenda - siehe nächste Seite



Standort
Eventhotel Pyramide & Congress Center
Parkallee 2 · 2334 Vösendorf · Österreich



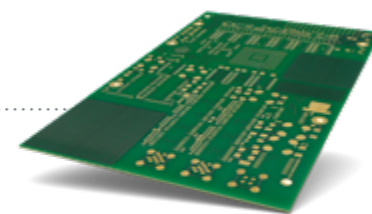
Gleich anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Anmeldeschluss 02. April 2024.

Anmeldung unter: www.we-online.com/tecday-wien



Begleitend zu den Vorträgen, steht Ihnen eine Tabletop-Ausstellung zur Verfügung

- Ausstellungsmaterial, Exponate der Leiterplatte
- Neuigkeiten aus dem Bereich Passive Bauteile (u.a. Hochstrom Induktivitäten, Hybrid Kondensatoren)
- Powermodule (u.a. Digitale Isolatoren)
- Funk & Sensorik (neues Bluetooth & LORA Modul)
- Highlights aus dem Bereich Elektromechnik (Hochstromsteckverbinder & Thermal Management)



AGENDA UND TAGESPLANUNG

Registrierung 08:00 – 08:15 Uhr

Begrüßung 08:15 – 08:30 Uhr

Programm ab 08:30 Uhr

Design for HDI-Manufacturing + Zuverlässigkeit und Impedanzen

Design for HDI-Manufacturing

- Tipps aus der Praxis zur Optimierung von Designs
- Grenzen verschiedener Herstellverfahren

Zuverlässigkeit und Impedanzen

- WE.SPEED: High Speed Materialien am Beispiel Panasonic Megtron6™
- Impedanzprüfung im Zeitalter von Hochfrequenz-Lagenaufbauten am Beispiel Panasonic Megtron6
- Interconnect Stress Test: Lessons Learned nach 10 Jahren IST Prüfung
- Zuverlässigkeit im Design

Referent: Andreas Dreher

SLIM.flex und PURE.flex

- SLIM.flex: Miniaturisierte Leiterplatten in Anylayer-Microvia-Technologie
- SLIM.hdi: Miniaturisierte Leiterplatten in Anylayer-Microvia-Technologie als Substrattechnik
- PURE.flex mit Stiffener: Materialien und Anwendungen

Referent: Michael Kress

Advanced Solutions & Innovationen

Suchen Sie nach einer Lösung? Wir werden sie finden!

DEVICE.embedding –

oder wie und warum steckt man Bauteile in die Leiterplatte?

- Kurzer Überblick über die Embedding-Möglichkeiten
- Design Rules für den PCB Designer
- Beispiele von Applikationsmöglichkeit

Referent: Leon Haase

Pausen zur Erholung

Ende der Veranstaltung, ca. 16:00 Uhr

WEdesign

- Bauteile/Bibliotheksanlange
- Layouting/Redesigns
- Simulation und Verifikation (thermisch, SI, PI)
- Bereitstellung optimierter Fertigungsdaten

Referenten: Jan-Philipp Bloksma, Michael Matthes

Printed Polymer und Wärmemanagement

„Lösungsbringer am Beispiel einer anspruchsvollen
Automotiv-Anwendung“

Referent: Andreas Dreher

ASIA PRODUCTION

- Ihr Partner für Leiterplatten aus Asien
- Mit 50 Expert:innen vor Ort in Asien
- Engineering, Beschaffung, Qualitätsüberwachung und Logistik aus einer Hand
- Von Mustern bis zur Großserie, von einfacher Technologie bis hin zu Hochtechnologie
- Produktportfolio
- Konfiguration

Referent: Alexander Görz

STARR.flex – die zuverlässige Verbindung im 3D-Bauraum

- Systembetrachtung
- Lagenaufbauten und Materialkombinationen
- Mechanische und elektrische Optionen
- Grundlagen | Motivation | Materialien | Kosten
- Praxisteil: Herstellung starrflexible Leiterplatten live

Referent: Werner Öchslen

